

## 半導体パッケージの製造方法とそのパッケージ

ダイシフトを抑えることが可能な製造方法とそのパッケージを提供！！

### 概要

半導体パッケージ、特にモバイル用途で主流のFan-out Wafer Level Package (FOWLP) 工法では、封止樹脂の流動で実装された部品が動き、規定位置からずれた状態で封止樹脂が硬化し、部品との配線不良が発生する「ダイシフト」という課題がある。またフレキシブルディスプレイのようなデバイスにおいても、デバイスを湾曲させた時に実装した部品がずれてしまうという課題がある。

前記課題を解決すべく、本発明は特殊なアンカー層を実装部品下部に取り入れ、また特殊な製造工程を採用することで、ダイシフトの無い半導体パッケージの製造を可能とした半導体パッケージの製造方法及びその半導体パッケージに関する発明である。

本発明により、ダイシフトが無く、高集積な半導体パッケージの製造が期待でき、さらにはフレキシブルディスプレイやウェアラブルデバイスへの応用が期待できる。

### 応用例

- μ-LED搭載フレキシブルディスプレイ
- フレキシブルウェアラブルデバイス用半導体パッケージ

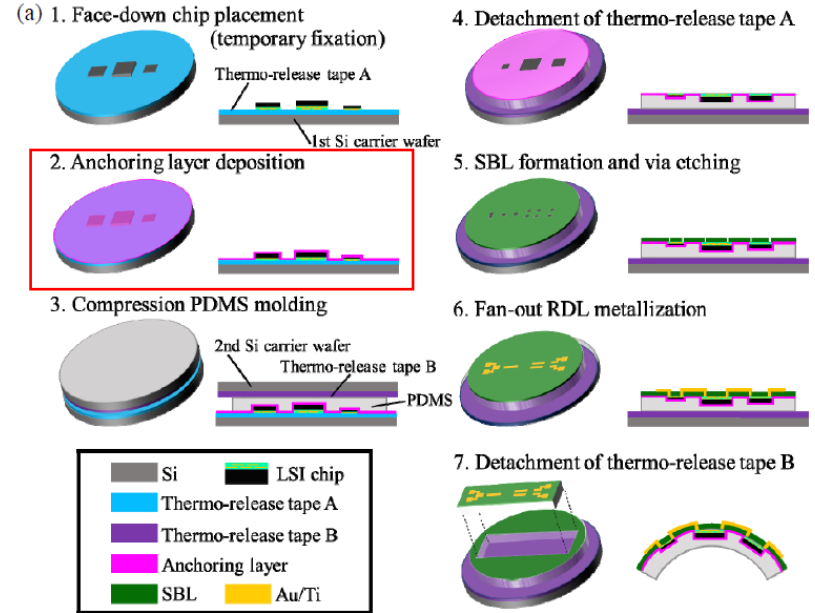
### 関連文献

- [1] T. Fukushima et al., IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, vol. 10, no. 8, pp. 1419-1422, Aug. 2020

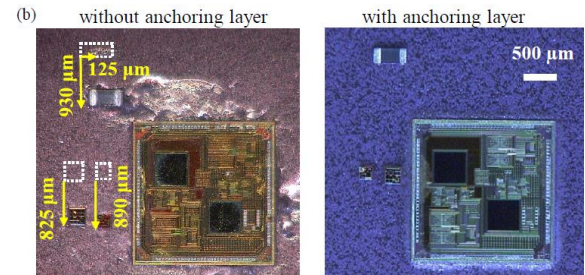
### 知的財産データ

知財関連番号 : WO/2022/025214  
 発明者 : 福島 誉史、田中 徹、木野 久志、煤孫 祐樹  
 整理番号 : T20-454

### 性能・特徴等



### 製造工程にアンカー層形成工程を導入



左図がアンカー層無、右図がアンカー層有  
 ⇒ ダイシフトを抑えることに成功！！

### お問い合わせ

本資料をダウンロード



お問合せ

<https://www.t-technoarch.co.jp/contact.html>



発明案件を随時更新中

<https://www.t-technoarch.co.jp/anken.php>



LinkedIn ページをフォロー

<https://www.linkedin.com/company/tohoku-techno-arch>



# Leading you to Successful Industrialization



株式会社

東北テクノアーチ

TOHOKU TECHNO ARCH